

# レベリング性に優れ、ピットが生じにくい装飾用硫酸銅めっき添加剤

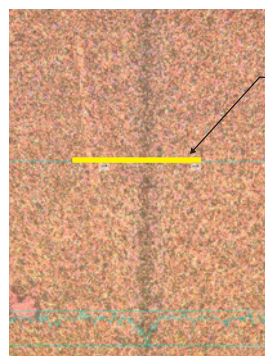
Additive for Acid Copper Plating with High Leveling Power, Can Reduce Pit

## TOP DuNC CU

- 素材キズの埋め込み性に優れ、美しい外観が得られる  
Can cover dent areas finely, can get beautiful appearance
- スラッジ発生量が少ない  
Reduce sludge amount
- ピットを生じにくい  
Can reduce pit
- 浴管理が容易  
Easy bath control

### 優れたレベリング性

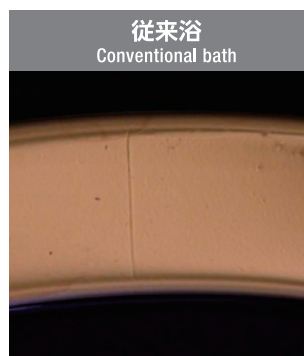
Excellent leveling power



深さプロファイル測定箇所  
Depth profile measuring spot  
Rz : 2.518 $\mu$ m (最大深さ)  
Maximum depth

硫酸銅めっき  
Acid copper plating

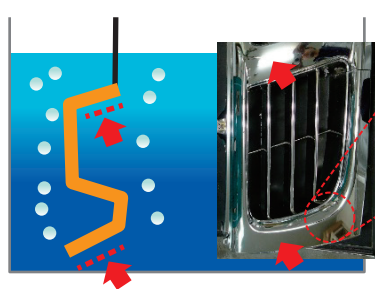
ABS成形品のウェルド部デプスプロファイル(エッチング18分)  
Molded ABS resin, weld-part depth profile (Etching: 18 min)



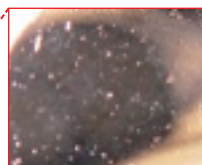
素材キズをレベリングし、美しい外観を実現  
Can cover weld part finely, can get beautiful appearance

### ピットを生じにくい

Prevent pit



----- エア攪拌が弱く、電流密度が高くなる  
Weak air agitation, high current density



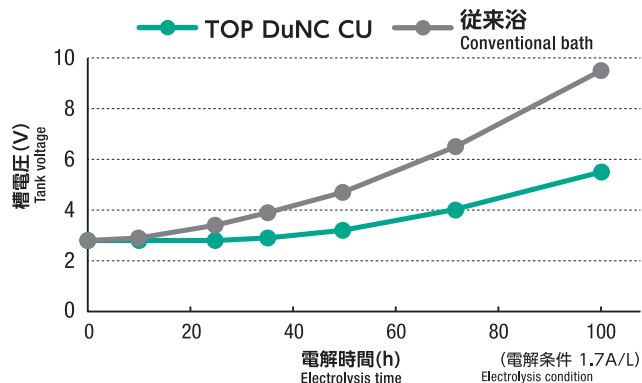
従来品: ピットを生じやすい  
Conventional bath: cause pit easily



ピットを 방지、外観が向上  
Prevent pit, improve appearance

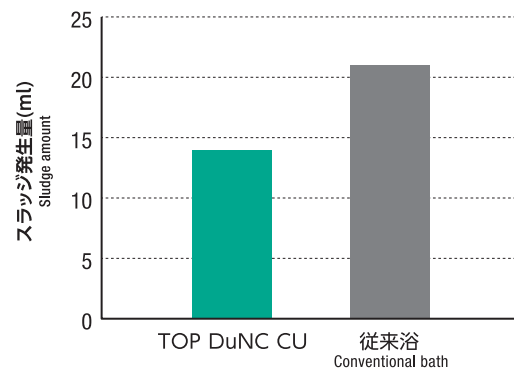
### 槽電圧の上昇を抑え、スラッジの発生を抑制する

Can stop tank voltage increase, prevent sludge occurrence



電解に伴う槽電圧の変化  
Tank voltage change by electrolysis

100時間後のスラッジ発生量をメスシリンダーで測定  
Measure sludge amount after 100 hour test



スラッジ発生量の比較  
Comparison of sludge amount